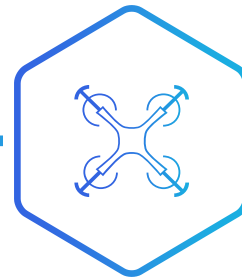
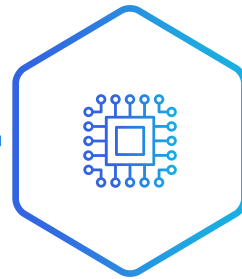


PI Advanced Materials

Polyimide Connecting Tomorrow

2026년 1분기 실적발표



Disclaimer

본 자료에 포함된 PI첨단소재 주식회사의 경영실적 및 재무성과와 관련된 모든 정보는 한국채택회계기준에 따라 작성되었습니다.

본 자료는 미래에 대한 예측 정보를 포함하고 있습니다.

위 예측정보는 향후 경영환경의 변화 등에 따라 영향을 받으며 본질적으로 불확실성을 내포하고 있는 바, 이러한 불확실성으로 인하여 실제 미래 실적은 예측정보에 기재되거나 암시된 내용과 중대한 차이가 있을 수 있습니다.

또한 향후 전망은 현재의 시장상황과 회사의 경영방향 등을 고려한 것으로, 향후 시장환경의 변화와 경영전략 수정 등에 따라 제공대상자료, 제공 양식 및 수치 등이 어떠한 사전 고지 없이 변경될 수 있음을 양지하시기 바랍니다.

본 자료는 어떠한 경우에도 투자자의 투자결과에 대한 법적 책임 소재의 입증자료로써 사용될 수 없습니다.

또한, 본 자료를 당사의 동의 없이 편집, 가공 또는 게재 할 수 없습니다.

1

2026년 1분기 실적

2

요약재무제표

3

회사소개

2026년 1분기 실적

매출 안정화 기반 수익성 구조적 개선 가속화

실적 요약

(단위: 억원, %, ton)

	1Q25	4Q25	1Q26	YoY	QoQ
매출	641	584	641	(0.1%)	9.6%
제품별					
필름	622	575	632	1.6%	9.9%
바니쉬 및 기타	19	10	9	(53.2%)	(6.7%)
용도별					
FPCB	318	308	331	4.0%	7.3%
방열시트	179	160	169	(5.7%)	5.4%
첨단산업 ¹	144	116	141	(2.2%)	21.6%
EBITDA ²	171	152	227	32.6%	49.5%
EBITDA율	26.7%	26.0%	35.4%	8.7%p	9.5%p
영업이익	86	66	140	62.8%	111.8%
영업이익률	13.5%	11.3%	21.9%	8.5%p	10.6%p
당기순이익	58	44	106	82.6%	139.9%
당기순이익률	9.1%	7.5%	16.5%	7.4%p	9.0%p
가동률	51.7%	38.6%	54.3%	2.6%p	15.7%p

1: 바니쉬 및 기타 매출은 첨단산업용 매출에 포함
2: 2025 회계 연도부터 Arkema 그룹 산정 기준 적용

리뷰

매출

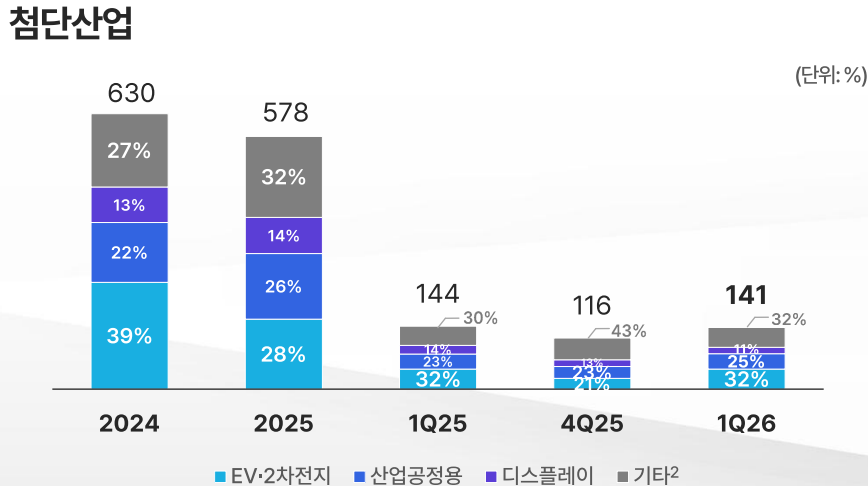
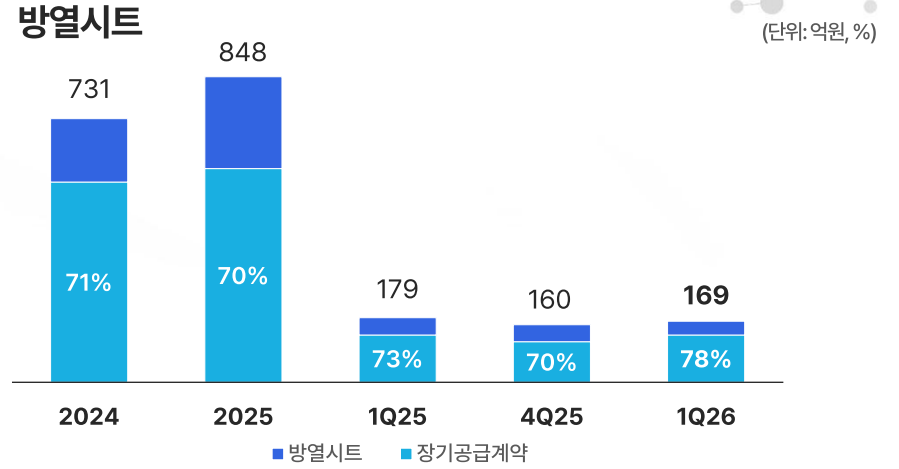
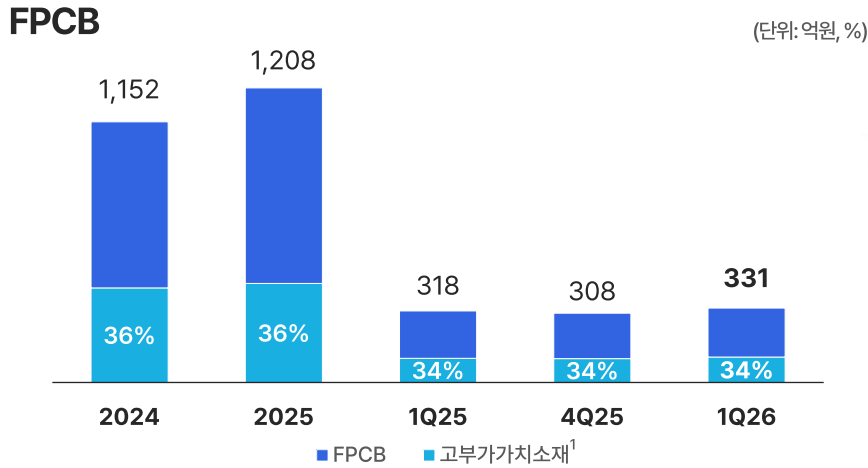
- FPCB용
 - 전년동기 및 전분기 대비 매출 성장
- 방열시트용
 - '26년 장기공급계약 체결 완료 및 고성능 방열 필름 매출 본격화
- 첨단산업용
 - YoY 판매량 유사 수준 유지

재고 / 손익

- Product mix 개선 및 환율 효과로 수익성 대폭 개선
- 전략적 판단에 따른 제품 및 원부재료 재고 수준 유지

용도별 매출 분석

FPCB용 전년동기 및 전분기 대비 매출 성장



리뷰

- **FPCB**
 - 레거시 제품 수요 견조 및 신제품 효과 동반으로 전년 분기 최대 매출 경신
- **방열시트**
 - 장기공급계약 체결 완료 후 매출 회복 흐름 확인
 - 고성능 방열 필름 매출 본격화
- **첨단산업**
 - 산업공정용 및 반도체용 필름 수요 지속

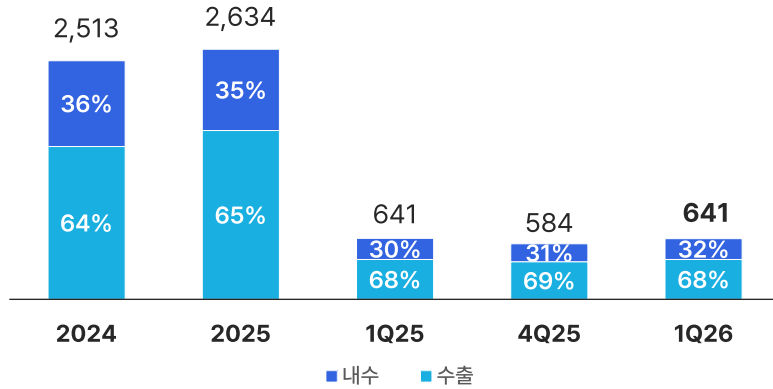
1: 초극박(<10μm) 및 블랙 필름
 2: 반도체용 필름 및 바니쉬, 기타 바니쉬, 기타용도 필름으로 구성

지역별 매출 분석

FPCB 내수 및 수출 매출 QoQ 동반 성장

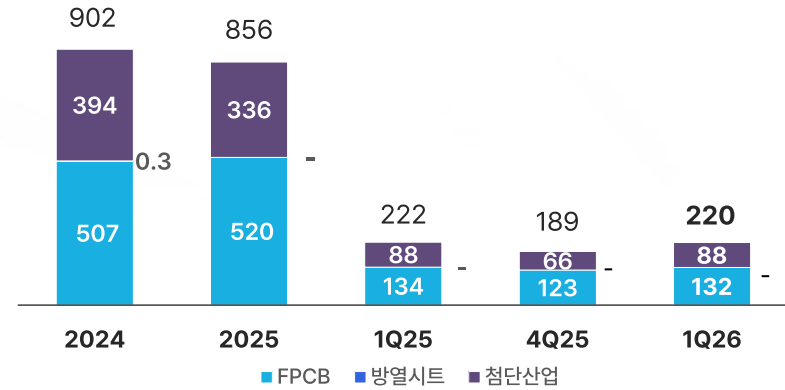
지역별 매출 비중

(단위: 억원, %)



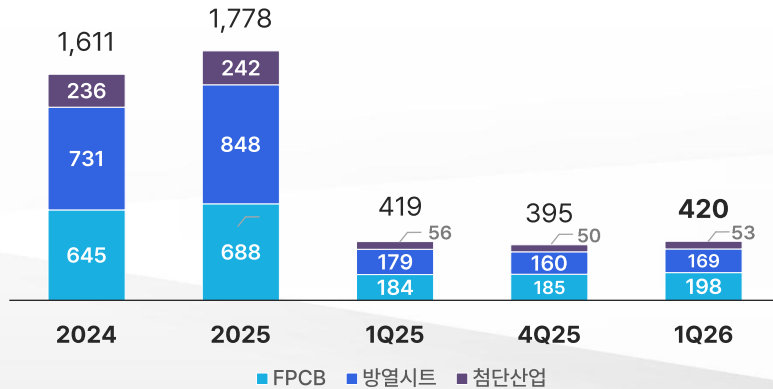
내수 용도별 매출

(단위: 억원)



수출 용도별 매출

(단위: 억원)



리뷰

- 내수 FPCB QoQ 7.7%, 첨단산업 QoQ 32.6% 성장
- 수출 FPCB YoY 7.6%, QoQ 7.0% 성장

재무 현황

지속적인 재무구조 개선을 통한 견고한 재무 안정성 확보

재무상태 & 현금흐름

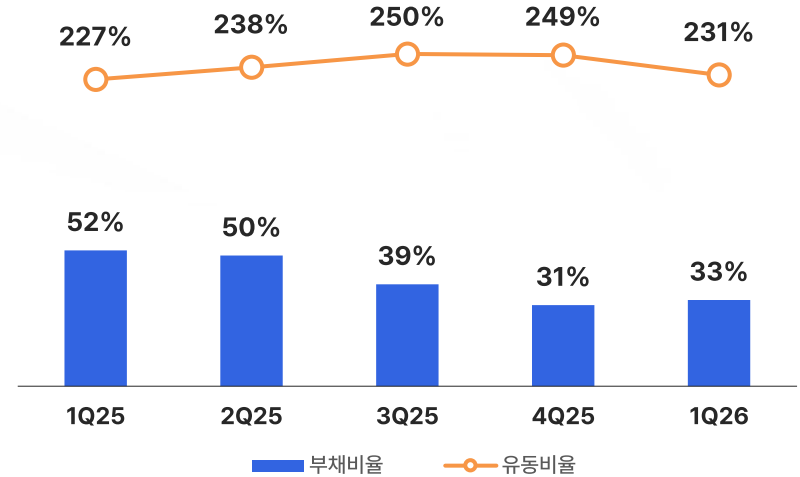
(단위: 억 원)

재무상태표	2025	1Q26
유동자산	1,226	1,387
현금 및 현금성자산	507	543
비유동자산	3,422	3,339
자산총계	4,648	4,726
장단기 차입금	459	429
부채총계	1,096	1,172
이익잉여금	2,311	2,314
자본총계	3,552	3,554

현금흐름표	2025누적	1Q26누적
기초 현금성자산	828	507
영업활동	+783	+79
투자활동	-50	-10
재무활동	-1,053	-35
현금자산 환율 변동	-1.3	+1.7
기말 현금성자산	507	543

재무 비율

(단위: %)



리뷰

- 단기차입금 전액 조기 상환에 따른 이자비용 절감 실현
- '26년 4월 현금배당 실시

2026년 2분기 전망 및 경영계획

2026년 2분기 전망

전년 및 전분기 대비 매출 성장 전망

- 2분기 중 신제품 효과 본격 반영
- FPCB 및 방열시트 수요 증가 예상

거시경제적 불확실성 지속

- 메모리 공급망 변동성 지속으로 당사 영향 예의 주시 필요
- 중동 지정학 리스크 장기화로 원부재료·물류 비용 및 공급망 불확실성 상존

수익 구조의 체질 개선 지속

- 고부가가치 제품 수요 본격화에 따른 Product-mix 개선
- 판매량 증가에 따른 생산 효율 개선 및 환율 효과 동반

경영 계획

스페셜티 중심의 P·Q 동반 성장 실현

- 저유전(Low-Dk), 고성능 방열, 플렉시블 필름 등 차세대 디바이스용 소재 공급 확대
- 고부가가치 제품군의 First-Mover 입지 활용한 시장 지배력 강화

사업 포트폴리오 다각화

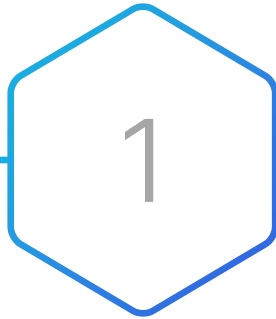
- 항공우주, 반도체 공정, 로봇틱스, 데이터 센터 등 신규 산업군 진입 검토
- 바니쉬, 파우더 성형품 등 비필름 제품군의 본격적인 시장 진입
- 추가 성장 동력 확보를 위한 신사업 진출·M&A 기회 선제적 검토

재무구조 지속 개선 및 수익성 방어

- 전략적 원부재료 구매 및 재고 관리 정책 추진으로 가격 상승 영향 방어
- 2분기 중 차입금 추가 상환 검토

PI Advanced Materials

Polyimide Connecting Tomorrow



2026년 1분기 실적



요약재무제표



회사소개

요약재무제표

재무상태표

(단위: 백만원, %)

	2024	2025	1Q26
자산총계	527,695	464,759	472,537
유동자산	160,009	122,591	138,677
현금 및 현금성 자산	82,815	50,682	54,259
부채총계	192,535	109,605	117,154
유동부채	74,936	49,202	60,012
장단기차입금	139,415	45,925	42,938
자본총계	335,160	335,154	335,383
이익잉여금	210,844	231,096	231,375
유동비율	213.5%	249.2%	231.1%
부채비율	57.4%	30.9%	33.0%
차입금의존도	26.4%	9.9%	9.1%

손익계산서

(단위: 백만원, %)

	2024	2025	1Q25	1Q26
매출	251,295	263,421	64,096	64,054
매출원가	188,441	191,186	48,153	41,888
매출총이익	62,855	72,235	15,942	22,166
매출총이익률	25.0%	27.4%	24.9%	34.6%
EBITDA	67,326	75,419	17,120	22,696
EBITDA이익률	26.8%	28.6%	26.7%	35.4%
영업이익	33,826	43,039	8,629	14,048
영업이익률	13.5%	16.3%	13.5%	21.9%
금융수익	1,791	2,509	532	284
금융비용	6,576	5,482	1,576	2,232
기타손익	(23)	(491)	7	1,698
법인세차감전순이익	29,019	39,576	7,593	13,798
당기순이익	22,272	30,385	5,782	10,558

PI Advanced Materials

Polyimide Connecting Tomorrow

1

2026년 1분기 실적

2

요약재무제표

3

회사소개

회사개요



Global No.1 Polyimide 전문 기업

설립



2008년 6월

자산



4,648억 원
(FY2025)

사업장



서울사무소/연구소,
진천공장/연구소,
구미공장

주주구성



대주주 54.07%,
국민연금 4.48%
(1Q26)

연매출



2,634억 원
(FY2025)

임직원



315명
(1Q26)

연혁

글로벌 1위 PI필름 기업에서



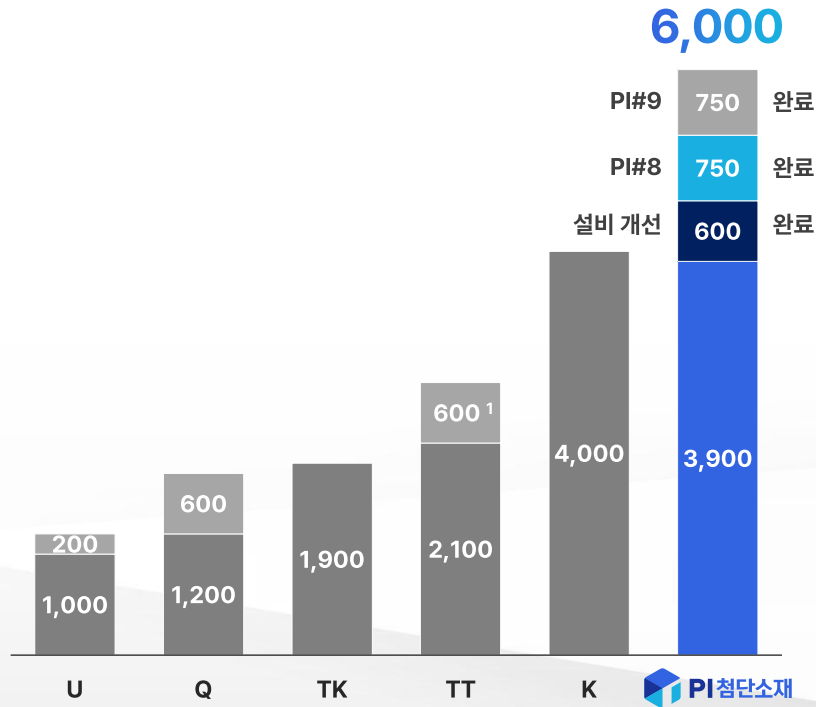
Global No. 1 Polyimide 전문기업

전세계 PI필름 판매량 및 생산능력 기준 2014년부터 1위 유지

PI필름 생산능력

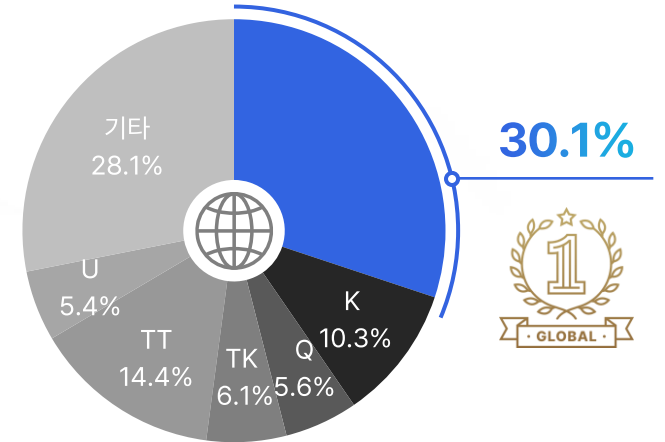
(단위: ton)

- 2021: 기존 설비 개선으로 연간 생산능력 4,500ton으로 확대
- 2022: 연간 생산능력 5,250ton으로 확대
- 2Q24: 연간 생산능력 6,000ton 이상으로 확대



1: 2027년 중 가동 예상

PI필름 시장점유율



용도별 생산 가능 영역

- 경쟁사 중 유일하게 모든 주요 용도 제품 생산 중

	방열	2차전지	FPCB	폴더블	5G	Chip on Film
PI첨단소재	●	●	●	●	●	●
K	●		●		●	
TT	●	●	●			
Q+TK	●	●	●		●	●
U			●			●

(출처: Yano Research, 회사자료)

Polyimide 란?

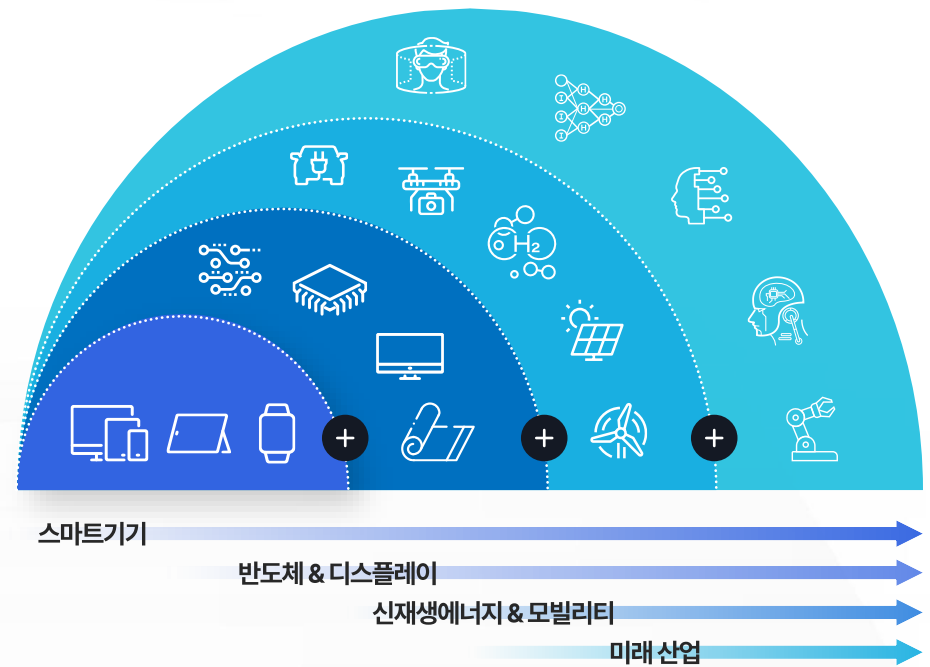
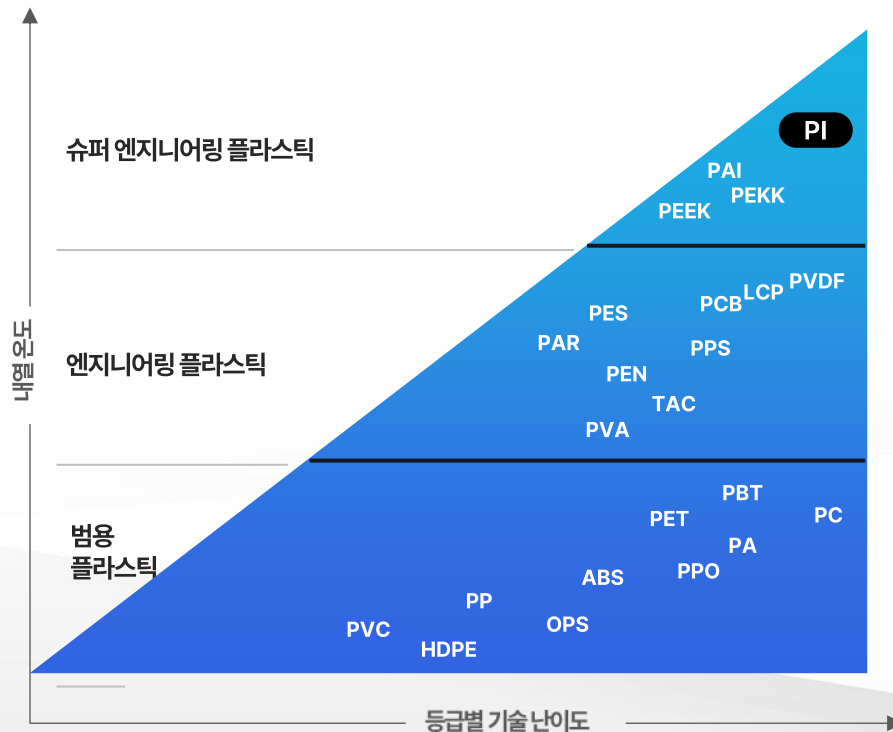
다양한 전방산업으로 확장 적용되고 있는 고기능 핵심소재

PI(Polyimide)의 특성

- -269°C ~ 400°C의 극한과 초고온에서도 변형이 없는 첨단 고기능성 산업용 소재
- 내열성, 치수 안정성, 절연성, 가공성이 상용화된 플라스틱 소재 중 가장 우수

전방산업의 확장성

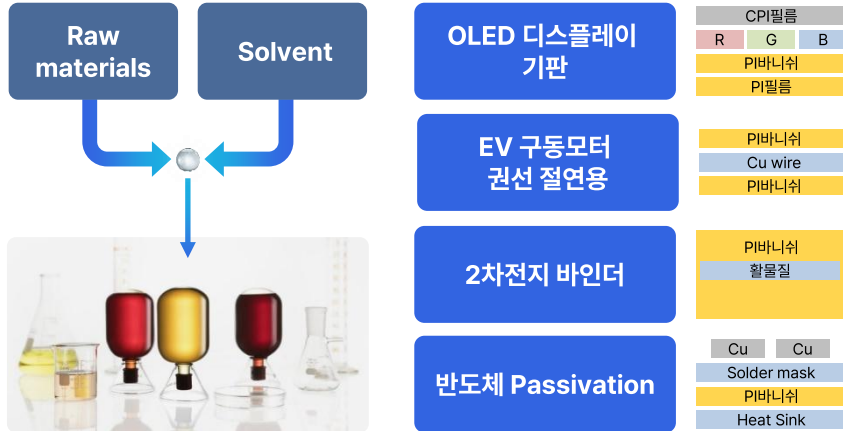
- 고성능 → 수요 확대 → 증설 → 가격 경쟁력 강화 → 시장·용도 확대
- 스마트기기 수요 중심에서 내구성 및 안정성 확보에 핵심적인 내열성과 절연성을 필요로 하는 다양한 전방산업으로 용도 확대 중



Polyimide 제품군 - 공정별

PI Varnish

Polymerization



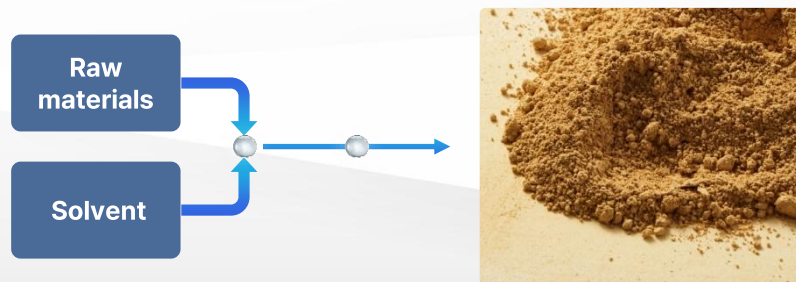
PI Film

Casting & Drying -> Curing -> Winding



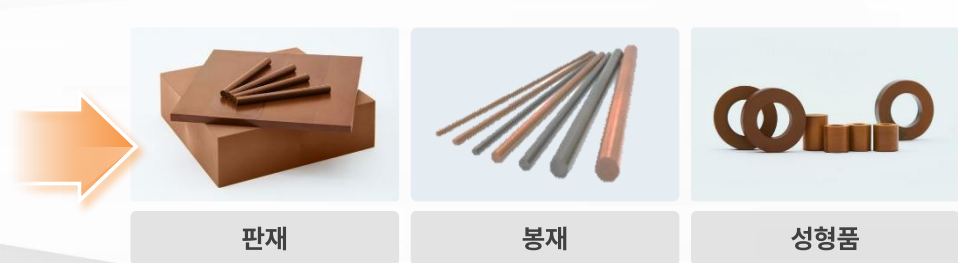
PI Powder

Polymerization -> Extraction/Drying






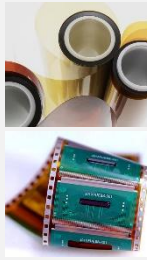

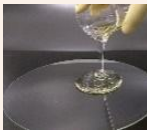




PI Molding

Compression



Polyimide 제품군 - 용도별

PI필름에서 바니쉬, 파우더까지 다양한 제품 라인업 출시 및 개발

	FPCB	방열시트	첨단산업
매출 (FY2025)	1,208억 원	848억 원	578억 원
매출 비중 (FY2025)	46%	32%	22%
 필름 Film	 <ul style="list-style-type: none"> 모바일 <ul style="list-style-type: none"> 3 Layer 2 Layer Coverlay 5G MPI 차량전장용 <ul style="list-style-type: none"> BMS 카메라 센서 디스플레이 	 <ul style="list-style-type: none"> 모바일 <ul style="list-style-type: none"> 일반 고후도 고성능 	 <ul style="list-style-type: none"> 모빌리티 & 산업공정 <ul style="list-style-type: none"> EV/2차전지 MLCC 기타 산업용 디스플레이 <ul style="list-style-type: none"> 폴더블 Chip on Film ("CoF") 기타
 바니쉬 Varnish	 <ul style="list-style-type: none"> 디스플레이 <ul style="list-style-type: none"> 유색/무색 OLED 디스플레이 기판용 		 <ul style="list-style-type: none"> EV <ul style="list-style-type: none"> EV 구동모터 절연용
 파우더 Powder			 <ul style="list-style-type: none"> 반도체 <ul style="list-style-type: none"> Photo-sensitive PI ("PSPI")
			 <ul style="list-style-type: none"> 산업용 내구재 <ul style="list-style-type: none"> 봉재 판재 성형

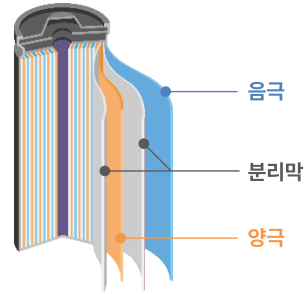
■ 주력 ■ 진입 □ 개발 중

Mobility 용도 상세

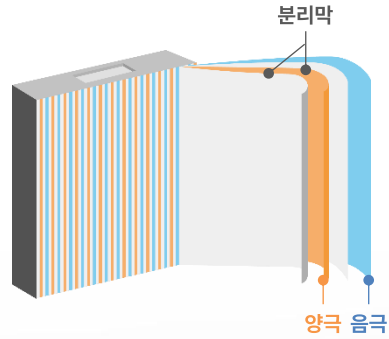
EV 배터리 절연용 필름



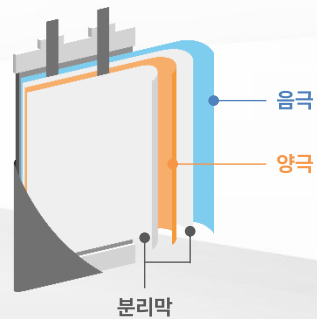
원통형
Cylindrical Type



각형
Prismatic Type



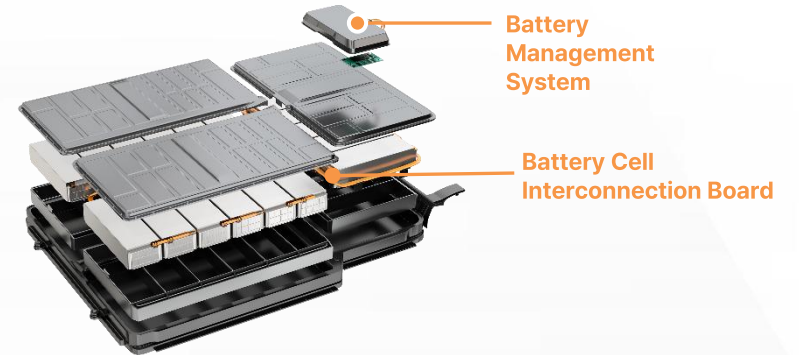
파우치형
Pouch Type



EV 구동모터 권선 절연용 바니쉬



BMS FPCB용 필름



중장기 전략 목표

2028년까지 비모바일 매출 50%+, 비필름 매출 20%+ 달성

2025		2028
77%	모바일	50% ↓
23%	비모바일	50% ↑
매출 용도 및 제품 다각화		
98%	필름	80% ↓
2%	바니쉬, 파우더	20% ↑

- 유럽 및 북미 지역으로 매출처 확장
- 신제품 출시로 매출 성장 견인
- 고속 성장하는 비모바일 용도, 고마진 필름 및 비필름 사업에 역량 집중하여 30%+ EBITDA 마진 달성

